

公司代码：688125

公司简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。
- 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 4 公司全体董事出席董事会会议。
- 5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本80,808,080股，以此计算合计拟派发现金红利40,404,040.00元（含税）。2022年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司股东的净利润157,113,932.79元的比例为25.72%。2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司上述利润分配预案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称

人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	安达智能	688125	不适用
------------	------------	------	--------	-----

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	易伟桃	袁菊红
办公地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号
电话	0769-38851180	0769-38851180
电子信箱	yiweitao@anda-dg.com	caiwu@anda-dg.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造设备的研发、生产和销售，产品主要包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉、组装机及 ADA 智能平台等在内的多种智能制造装备，可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等多领域电子产品的智能生产制造，是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备。

历经多年发展和技术积累，公司围绕智能制造装备积累了包括高精度点胶技术在内的 16 项核心技术，已形成核心零部件研发、运动算法和整机结构设计的一体化技术平台，依托一体化技术平台，公司的智能制造装备已在技术水平、生产效率和交付速度等方面具备较强的竞争优势，已与包括全球电子头部客户及其 EMS 电子信息产业链客户建立了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其在点胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产。

2、主要产品

公司是国内较早从事流体控制设备研发和生产的企業，2009 年推出选择性涂覆机，2010 年成功研发“国内首款全自动多功能高速点胶机”，随后相继推出包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备及核心零部件，形成了以高端流体控制设备为核心、覆盖多道工序的多元化产品布局。


（1）流体控制设备

流体控制设备主要包括点胶机、涂覆机、喷墨机和灌胶机等。流体控制设备可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域产品的 SMT 电子装联、FATP 后段组装的点胶和 TP 触摸屏涂覆等，以实现电子产品的贴装和部件组装。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品性能
点胶机	AD系列	AD-16智能精密点胶机	1.用途：用于包括消费电子产品在内的SMT段

			<p>点胶，包括点红胶、底部填充、零件包裹，IC补强等工序。</p> <p>2.主要参数：X/Y/Z轴精度可达0.01mm，重复精度可达0.01mm；最大移动速度可达1500mm/s。</p> <p>3.产品特点：XY轴采用直线电机，运动精度更高；集成CCD视觉系统，可分配胶量、抓拍轨迹、扫描条码；可选配双阀同步点胶。</p>
	<p>AD16-BDW半导体智能精密点胶机</p>		<p>1.用途：用于半导体产品封装点胶，包括IC点围坝胶、封装、零件包裹、芯片底部填充等。</p> <p>2.主要参数：X/Y重复精度可达0.005mm；最大移动速度可达1300mm/s，最大加速度1.5G。</p> <p>3.产品特点：带洁净送风单元，满足半导体加工洁净度要求；铸造结构可减少设备晃动；采用双层往复式上下料方式；搭配AOI检测及定位功能及激光高度检测系统，实现整机精度检验。</p>
		<p>iJet-7H智能精密点胶机</p> 	<p>1.用途：用于电气元器件底部填充、引脚包边、表面贴装点胶等工序。</p> <p>2.主要参数：X/Y重复精度可达0.01mm；最大移动速度可达1000mm/s，最大加速度1.5G。</p> <p>3.产品特点：可根据工艺需求，选配双轨双阀或单轨双阀结构，点胶行程最大可达400mm；可实现四方位倾斜，可选配增压泵、激光测高系统等。</p>
<p>iJet系列</p>	<p>iJet-8M多功能高速点胶机</p>		<p>1.用途：热熔胶粘接、底部填充、引脚包封、堆栈封装POP、围坝与填充、点红胶、FPC元器件补强等。</p> <p>2.主要参数：重复精度±0.015，最大移动速度1200mm/S。</p> <p>3.产品特点：(1)设备为在线式点胶设备；(2)采用直线电机+运动控制卡；(3)可直接导入任何品牌的贴片机文件，也可在线视觉编程；(4)可选配激光高度检测系统，工件变形后可自动校准Z轴高度；(5)可选配精密测重系统，智能控制及检测点胶量，确保点胶的一致性；(6)可选拓展工艺模块丰富、满足客户不同点胶工艺需求。</p>

		<p>iJet-9智能精密点胶机</p> 	<p>1.用途: LED等大尺寸产品专用点胶机, 包括引脚包封、表面贴装、FPC元器件补强等。</p> <p>2.主要参数: 重复精度可达0.02mm; 最小点胶直径0.5mm; 最大移动速度可达800mm/s, 理论每分钟最大胶点数20000点。</p> <p>3.产品特点: 单阀X轴点胶行程可达860mm; 可进行双板同时点胶; 整机模块化设计, 灵活可升级; 搭配CCD视觉系统, 实时监测点胶精度和一致性。</p>
	TSV桌面点胶系列	<p>TSV-300桌面点胶机</p> 	<p>1.用途: 热熔胶粘接、底部填充、引脚包封、堆栈封装POP、围坝与填充、点红胶、FPC元器件补强等。</p> <p>2.主要参数: 重复精度±0.025, 最大移动速度800mm/S。</p> <p>3.产品特点: 设备为离线式点胶设备、桌面点胶设备, 占地空间较小, 采用线性模组+伺服电机驱动。</p>
	ADG系列	<p>ADG-5DI五轴高速点胶机</p> 	<p>1.用途: 热熔胶粘接、底部填充、引脚包封、堆栈封装POP、围坝与填充、点红胶、FPC元器件补强等。</p> <p>2.主要参数: 重复精度±0.012, 最大移动速度1000mm/S。</p> <p>3.产品特点: (1) 设备为在线式点胶设备; (2) 采用直线电机+运动控制卡; (3) 使用五轴联动控制技术, 可实现产品空间任意点胶轨迹需求; (4) 可直接导入任何品牌的贴片机文件, 也可在线视觉编程; (5) 可选配激光高度检测系统, 工件变形后可自动校准Z轴高度; (6) 可选配精密测重系统, 智能控制及检测点胶量, 确保点胶的一致性; (7) 可选拓展工艺模块丰富、满足客户不同点胶工艺需求。</p>
涂覆机	iCoat系列	<p>iCoat-3选择性涂覆机</p> 	<p>1.用途: 适用于多行业涂覆应用, 可进行多拼版的涂覆, 满足客户高产能需求; 可进行制程工艺多样的大面积选择性涂覆。</p> <p>2.主要参数: 重复精度0.02mm; 最大移动速度800mm/s, X/Y轴行程最大可达450mm。</p> <p>3.产品特点: 可根据工艺需求, 选择多种行程规格的设备; 可配备多种阀体, 进行多阀排列, 适应多样拼板生产需求。</p>
		<p>iCoat-5选择性涂覆机</p>	<p>1.用途: 对电子元器件和引脚等进行精确选</p>

			<p>择性涂覆，提升对电子元器件保护强度。</p> <p>2.主要参数：重复精度0.02mm；最大移动速度800mm/s；传输速度2-13m/min。</p> <p>3.产品特点：可进行多方位多角度喷涂，解决高精度零件死角喷涂问题。</p>
--	--	---	--

(2) 等离子设备


等离子设备主要有真空等离子清洗机 and 常压等离子清洗机，用于清洗 FPC、PCB、半导体引线支架、玻璃和各种手机零部件等表面有机物，以提高产品表面附着力，从而提升产品可靠度。

产品系列	典型产品图示	产品性能
VP系列	VP-10L在线式真空等离子清洗机 	<ol style="list-style-type: none"> 用途：清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件等表面有机物，提高表面附着力。 主要参数：可实现超低温清洗，温度最低至40度；抽真空时间15秒，破真空时间5秒，水滴角度最小可达10°。 产品特性：在线式清洗，全方位低温表面清洗，异向等离子体可以进入超细狭缝清洗。
	VP-80系列全自动离线式等离子清洗机 	<ol style="list-style-type: none"> 用途：清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件等表面有机物，提高表面附着力。 主要参数：可实现超低温清洗，温度最低至40度；射频电源0-500W可调节。 产品特性：真空腔体采用铝合金制作而成；全方位低温表面清洗，异向等离子体可以进入超细狭缝清洗。
AP系列	AP-3P常压等离子清洗机 	<ol style="list-style-type: none"> 用途：对产品表面要求不高的FPC、PCB、手机零部件等表面有机物进行清洗，提高表面附着力。 主要参数：温度最低至55度；水滴角度最小可达10° 产品特性：清洗速度快、适用广、使用门槛低，相较于真空等离子清洗机而言，供气类型更加多样，可选压缩空气或氮气；使用成本低。

(3) 固化及智能组装设备

固化设备包括红外固化炉、紫外固化炉和热风固化炉，主要用于产品完成点胶或涂覆、灌胶或打印等工序后的固化或烘干。智能组装设备主要用于零部件贴装和组装，如贴装、插装、锁付等工序，包括上料机、下料机和传输设备等其他设备。

ADA 智能平台是在通用机架的基础上搭载主机模组形成一个通用平台，再在通用平台基础上上搭载不同的工艺模块、供料模块、输送和校准模块以快速形成一台智能平台设备，实现给什么工具和物料就能完成相应的工序工作，如点胶、涂覆、组装、等离子清洗、锁螺丝、视觉检测等。ADA 智能平台的“智能”体现在设备具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应的特点，能有效解决制造业设备不通用、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的行业四大痛点问题。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品性能
固化设备	红外固化	<p>iCure-2/3/4 红外固化炉系列</p> 	<p>1.用途：用于热固胶水涂覆后的固化。 2.主要参数：可选配2至4个温区系统；温度精度可控制在±5℃ 3.产品特性：双层炉腔设计，隔热效果更佳；可拆卸式温区维护、更便捷；多段式独立控温，PID调节，节能高效。</p>
	紫外固化	<p>UV固化炉系列</p> 	<p>1.用途：UV胶水涂覆或者点胶后的固化。 2.主要参数：功率可调，灯管理论使用寿命可连续工作2000小时。 3.产品特性：自制光源及先进变频电源技术，有效保证紫外能力稳定输出，大幅降低能耗；多样性光源组合，汞灯、无极灯管/LED等可满足多种固化方式。</p>
	热风固化	<p>垂直热风固化系列</p> 	<p>1.用途：手机背板及盖板（CG与BG）喷墨后的预固化。 2.主要参数：上部4个加热模块，独立控温，温度从室温至130℃可任意设定。 3.产品特性：每个模块采用电阻丝加热，高温马达及风轮运风，配有加热箱及整流板；采用立式固化设计，极大节省空间。</p>
智能组装及其他	智能组装设备	<p>OSA密封圈组装机系列</p> 	<p>1.用途：电子零部件的高速自动组装，实现自动取料、放料、组装和检测等功能。 2.主要参数：最快可于1.2秒内完成一个零部件的组装，且良率高达95%。 3.产品特性：包含真空泵、上下料机构、取料等部件，可加载CCD视觉模块，在高速组装同时同步完成视觉检测。</p>

	上下料机	<p>LD-460W供料系统</p> 	<p>1.用途：用于自动化产线前后端自动上料与收料。</p> <p>2.主要参数：过板宽度可在50-460mm范围内任意调节。</p> <p>3.产品特性：采用整体钣金焊接机架，减少设备晃动，减少胶体流动性。</p>
	传输设备	<p>ADJ-460自动接驳台</p> 	<p>1.用途：用于SMT涂覆生产线、点胶生产线及定制化生产线。</p> <p>2.主要参数：过板宽度可在50-460mm范围内任意调节；可选0.5m、0.8m两种设备长度规格。</p> <p>3.产品特性：采用整体钣金焊接机架。</p>
	ADA智能平台H系列	<p>龙门式 侧悬式</p> 	<p>1.用途：多工艺模块化的平台型通用设备。</p> <p>2.主要参数：XY最大移动速度1500mm/s，XY重复定位精度±0.01mm。</p> <p>3.产品特性：（1）机架均为一体开模成型，钢性好，且整机组装完成后，会进行激光干涉仪校正；（2）整个主机模组独立控制，可快速拔插，实现工艺切换，并与MES系统连接；（3）每个工艺模块采用标准化设计，支持整体快速拔插；所有工艺模块都带有嵌入式微电脑+Linux系统，可实现软件自控与参数存储；所有工艺模块都带视觉模块，可自动定位和识别；（4）所有工艺模块都有唯一的IP地址，快速对接后上位机能自动识别，不同的工作头插入后，自动运行相关软件及程序。</p> <p>4.应用特点：可以单机、多机连线生产模式，换线转产只需更换模块即可。</p>

（4）配件及技术服务

技术服务业务是公司为保障客户生产线的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体内容包括智能制造装备的操作培训、定期检查、维护保养、故障分析等，贯穿了客户智能化生产的全生命周期，有效提升客户黏性。

主要配件	典型产品图示	产品性能
------	--------	------

点胶阀	<p>气动喷射阀体JET-8600</p>  <p>PV-09A压电喷射阀</p> 	<p>1.用途：用于消费电子、照明行业、汽车工业等多领域的表面贴装胶、导电银浆、IC封装胶、底部填充胶等工序环节。</p> <p>2.主要参数：</p> <p>（1）采用气动式喷射阀设计，粘度范围可达1-250,000mPa·s，能满足大部分胶水的粘度要求；</p> <p>（2）采取压电驱动方式，可实现0.002毫克级别的精准点胶，最快持续运行工作频率可达1000Hz，点胶直径线条宽度最小可精细到0.3mm，最佳粘度范围可达1-500,000mPa·s。</p> <p>3、特点：单一机械部件可进行调整，可用性高；设有消声设计，充分降低噪音。</p>
涂覆阀	<p>涂覆阀体SA-W5</p> 	<p>1.用途：用于消费电子、汽车工业等多领域的涂覆环节。</p> <p>2.特点：</p> <p>（1）采用突出式针头设计，零残留、无需拆卸即可清洗，溶剂型涂层厚度可达10-200微米，100%固含量涂料层厚度可达100-200微米；</p> <p>（2）采用锥形喷雾阀结构设计，粘度范围0-3500cP·S，可用于丙烯酸类、硅类、环氧类、UV胶等胶体的喷涂。</p>

(5) 柔性生产解决方案

除单一设备外，公司还可为客户提供应用于PCBA加工、3D玻璃和手机组装等领域的柔性生产组合方案。以PCBA板涂覆解决方案为例：该生产线以iCoat3系列涂覆机为主体，配有自动升降机、接驳台、UV检测台、UV固化炉等装置；此外，PCBA涂覆生产线还可选择双机（涂覆机）双炉等定制化方案。因涂覆所用胶体流动性相对高，成套生产线可减少胶体流动，最大程度保证加工工艺稳定性。



(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司已建立覆盖智能制造装备研发、生产和销售为一体的完整业务模式，依据对产品的前期

研发投入、生产成本等因素制定产品价格，通过向客户销售智能制造装备、提供配件及技术服务实现盈利。

2、采购模式

公司主要根据生产计划和研发需求，下达采购订单。此外，公司亦会根据与客户沟通的预测订单安排批量生产，并依此提前采购一部分通用物料，以满足生产排产的领料需求。公司直接采购的物料以标准化零配件为主，此外还委托部分供应商进行部分五金件和机加件或电气件的简单加工，即外协加工模式，公司向其支付加工费。

3、生产模式

公司以自主生产为主，对少部分附加值较低的钣金件、机加件和电气件的简单加工以委托加工方式进行。在生产组织方面，公司为订单导向型，生产计划主要根据销售订单及客户告知的订单预测情况执行，公司会通过与客户深入沟通，充分了解主要客户当年度的预计产能需求，并根据客户生产计划着手开始进行材料采购、制定生产计划，确保生产计划均衡分配、按时完成、准时发货；在生产工艺方面，公司产品在标准设备的基础平台上，通过加载工艺模块、变更关键核心零部件或优化运动算法等方式，即可满足客户多样化的工艺需求。当客户有特殊的工艺需求时，公司亦会根据客户需求定制化生产。

4、研发模式

公司建立了研究院+研发中心+应用研发“三层”研发体系。其中，研究院牵头基础研发，主要负责基础模块建设、核心零部件研发；研发中心则负责基础平台搭建、软硬件平台整合；应用研发由各个事业部中心牵头，负责针对市场及客户对产品的工艺要求进行产品升级研发，解决客户现场的应用问题。

5、营销模式

公司产品以直接销售为主。公司依托深厚的技术积累和快速交付等优势，实现了与全球头部电子信息产业客户及其 EMS 厂商的互赖互信，建立了长效而稳定的合作机制。公司直接与客户或其 EMS 厂商签订订单并发货，为其提供相关的智能制造装备及解决方案、零配件和技术服务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为流体控制设备、等离子设备、固化及智能组装设备等智能制造装备的研发、生产与销售，根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），属于“2.1 智能制造装备产业-3569 其他电子专用设备制造”。根据国家发展改革委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司产品属于“2.1.4 智能加工装备”中的“智能基础制造装备”。

（1）行业发展阶段

公司生产的流体控制设备属于电子专用设备制造行业和智能制造装备行业，智能制造装备行业是电子信息制造业实现自动化、智能化的必备条件和关键环节，而智能制造装备的技术水平更

是下游制造业突破工艺和产能限制的关键技术瓶颈。电子信息制造业向高精度、小型化方向发展的速度加快，对生产工艺进步的速度提出了更高要求。技术进步带来的生产工艺变革，必将带来对智能制造装备的更新换代需求。但目前智能制造装备普遍存在定制化程度高的特征。因此，生产工艺的迭代对生产线的柔性化需求不断加大。

当前，制造业自动化面临四大行业痛点，即：自动化设备通用性低、故障排除时间长、操作门槛高、柔性化不足。以设备通用性为例，各类电子产品因生产工艺不同需使用专用电子设备；同一产品生产线因工序环节不同，亦需不同的生产设备进行生产。以上行业痛点，使得企业智能制造装备购置、人力资源培训、设备更新换代等成本较高，将成为制约电子信息制造业推动自动化和智能化升级的重要因素。

(2) 行业基本特点

① 关键核心零部件技术积累薄弱

核心零部件的结构设计和加工精度是影响智能制造装备技术水平的重要因素之一。但由于我国高端制造业起步较晚，对制造业上游的覆盖力尚显不足。根据信通院《中国工业经济发展形势展望（2020年）》的数据显示，我国在核心基础零部件、关键基础材料、基础技术和工业等产业对外技术依存度在50%以上。

而在当前贸易环境不确定性加剧的背景下，对海外供应商的核心基础零部件、关键基础材料等的依赖将成为我国制造业平稳健康发展的关键阻碍。虽然目前部分企业已开始针对性地进行核心零部件的研发，但在加工工艺和基础材料等方面，仍与全球领先技术存在较大差距，在部分高端制造业领域无法摆脱对外技术依存。

② 高端制造领域的设备国产化程度有待提升

历经多年发展，我国自主研发和生产的各类智能制造装备已覆盖多种电子产品的多个工序环节，但在部分对技术参数要求更高、加工工艺精细度要求更高的制造业，国产智能制造装备的技术水平仍与国际领先企业存在差距。

(3) 主要技术门槛

智能制造装备行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型行业，跨越多个学科和技术领域且更新迭代快，是下游终端制造业突破工艺和产能限制的关键瓶颈。因此需要企业在包括先进制造、信息技术、人工智能等领域进行大量技术积累，需要持续的研发投入，以及储备多年的行业应用经验，对下游行业技术变革具备深刻理解，才能够在行业中立足并建立竞争优势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司于2009年率先推出智能选择涂覆机，于2010年推出经广东省电子学会SMT专业委员会认证的“国内首款全自动多功能高速点胶机”，是国内较早从事流体控制设备研发和生产的公司，产品主要应用于SMT电子装联、FATP后段组装的点胶和TP触摸屏涂覆等工序。2021年公司推出标准化、通用化的ADA智能平台设备以全面覆盖FATP后段组装工序。在业务方面，公司已奠定了流体应用核心产品基础，并已形成覆盖点胶、涂覆、等离子清洗、固化、智能组装等多道工序

环节的多元化产品布局；在技术方面，公司基于基础技术的积累，围绕智能制造装备形成了核心零部件研发、运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局，并在点胶机、涂覆机、智能 ADA 平台设备等核心产品领域具备了技术优势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着全球工业水平的提升，全球电子信息制造业不断向着高精度、低功耗、高效率、高集成、小型化和智能化等方向发展，终端产品在高精、高速、高质的追求上不断提升，一方面是对加工精度、装配工艺、效率产能、一致性和安全作业要求提升，部分工序无法继续以人工方式进行，需以电子专用设备替代；另一方面对加工所用的电子专用设备的精度、速度、稳定性、和特殊参数提出了更高要求。因此，随着电器元器件向微型化方向不断进步，电子信息制造业对加工工艺及设备的要求亦在不断提升，在为智能制造装备行业带来持续稳定的市场需求同时，亦对智能制造装备的技术提出了更高要求。

在通讯技术、芯片制程、材料工艺改良、数字孪生和 AI 等技术进步的推动下，近年来电子产品更新迭代速度不断加快，从而使得电子信息制造业需不断改变生产工艺，对电子专用设备的柔性化需求提升。5G 技术将成为众多下游电子产品更新换代、生产工艺升级的关键动因，为智能制造装备行业带来新一轮的需求爆发。此外，电子信息制造业向高精度、小型化方向发展的速度加快，对生产工艺进步的速度提出了更高要求。技术进步带来的生产工艺变革，必将带来对智能制造装备的更新换代需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	205,780.853066	85,309.321974	141.22	67,014.34
归属于上市公司股东的净资产	190,131.989317	69,272.529361	174.47	53,018.03
营业收入	65,131.552589	62,811.322968	3.69	50,669.03
归属于上市公司股东的净利润	15,711.393279	15,277.202433	2.84	13,340.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,164.46	14,318.85	5.91	12,359.68
经营活动产生的现金流量净额	14,046.805956	12,907.570793	8.83	8,342.22
加权平均净资产收益率(%)	10.59	24.99	减少14.40个百分点	27.92
基本每股收益(元/股)	2.12	2.52	-15.87	2.22
稀释每股收益(元)	2.12	2.52	-15.87	2.22

东莞市盛晟实业投资有限公司		42,628,800	52.75	42,628,800			无	境内非国有法人
东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）		9,001,260	11.14	9,001,260			无	境内非国有法人
刘飞		4,800,000	5.94	4,800,000			无	境内自然人
何玉姣		2,549,940	3.16	2,549,940			无	境内自然人
中金公司—杭州银行—中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-43,000	1,616,908	2.00	1,616,908	1,659,908		无	境内非国有法人
张继军		1,020,000	1.26	1,020,000			无	境内自然人
招商银行股份有限公司—宝盈成长精选混合型证券投资基金		714,002	0.88				无	其他
中国中金财富证券有限公司	-168,300	650,965	0.81	650,965	808,080		无	国有法人
中国建设银行股份有限公司—长城优化升级混合型证券投资基金		634,697	0.79				无	其他
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金		629,719	0.78				无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				不适用				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

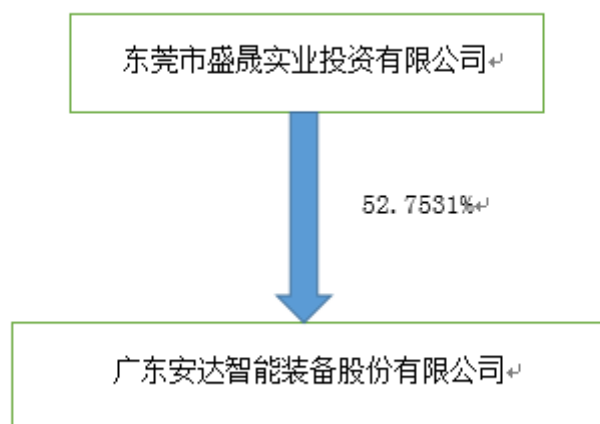
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

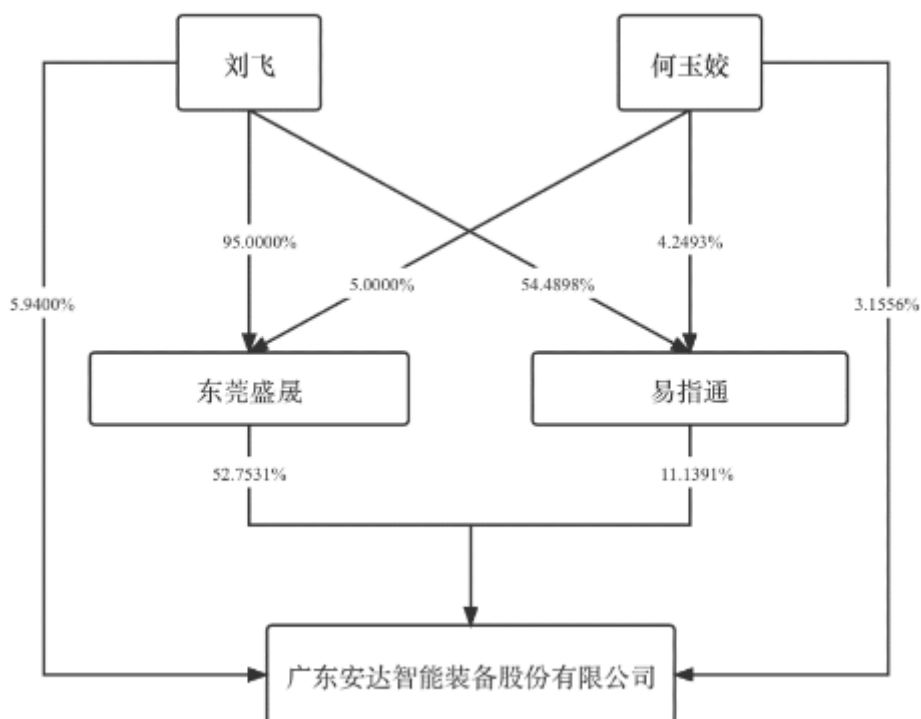
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 65,131.55 万元，较上年同期增长 3.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,711.39 万元，较上年同期增长 2.84%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,164.46 万元，较上年同期增长 5.91%；2022 年期末总资产 205,780.85 万元，较期初增长 141.22%；期末归属于母公司的股东所有者权益 190,131.99 万元，较期初增长 174.47%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用